

ET-MKC

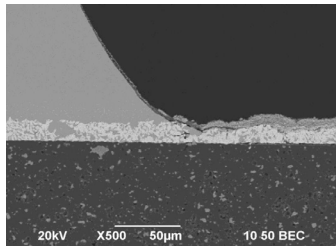
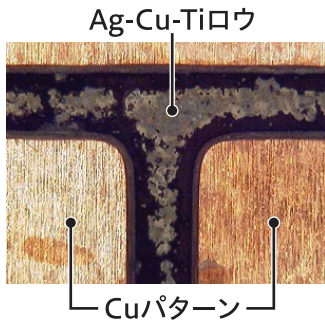
放熱板(ヒートシンク)/DBC基板上Ag-Cu-Tiロウ材の除去プロセス

1

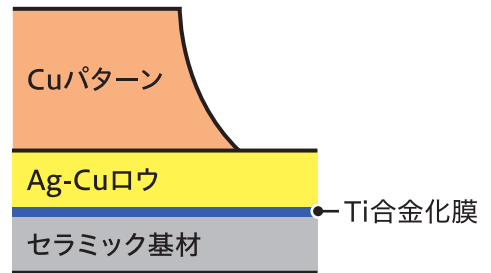
放熱板(ヒートシンク)

Ag-Cu-Tiロウ除去前

Cuとセラミック基材をAg-Cu-Tiロウで接合する。



Ag-Cu-Tiロウ除去前

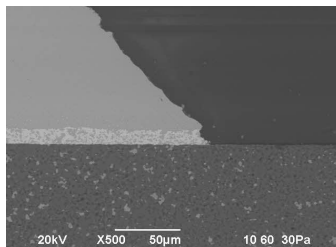
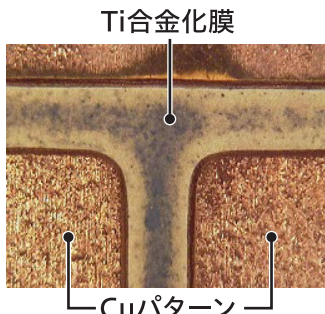


2

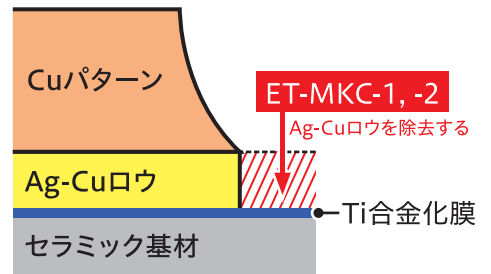
ET-MKC-1,-2処理 (Ag-Cuロウ除去)

Ag-Cuロウ除去

Cuパターンの溶解を抑えて、Ag-Cuロウを除去する。



Ag-Cuロウ除去後

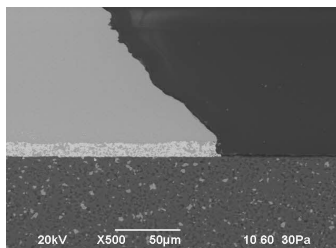
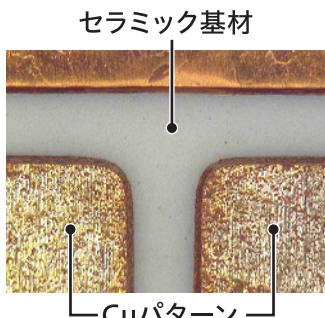


3

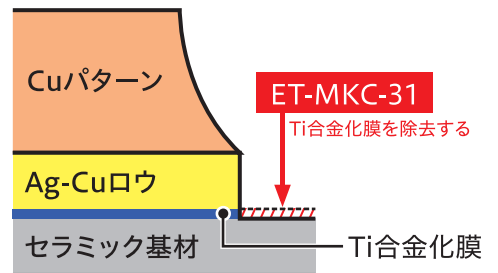
ET-MKC-31処理 (Ti合金化膜除去)

Ti合金化膜除去

Cuパターン、Ag-Cuロウの溶解を抑えて、Ti合金化膜を除去する。
Cuパターンとセラミック基材間のAg-Cuロウが溶解せず、アンダーカットにならない。
液寿命が良い。(数バッチ処理可能)



Ti合金化膜除去後

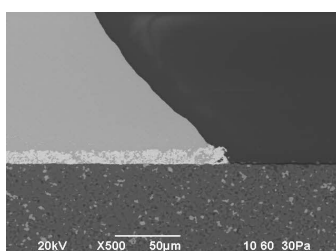
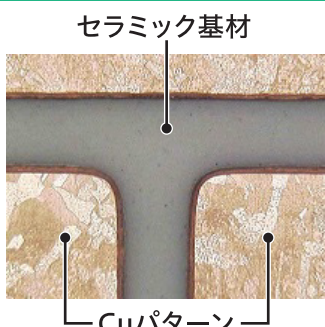


4

ソフトエッチング処理 (ロウ材フィレット形成)

ソフトエッチング処理

Cuパターンをエッチングして、表面を均一化する。
ロウ材フィレットを形成して、物理的強度を上げる。



ソフトエッチング処理後

